

〔A〕

苏州市科学技术局文件

苏州科提复〔2026〕123号

签发：徐积明

对市政协十五届五次会议 第051号提案的答复

市九三学社：

你们提出的“关于推动苏州前沿半导体产业高质量发展的建议”收悉，提案立足全球半导体产业重构趋势，精准把握苏州半导体产业发展基础与短板，提出的建议贴合实际，为我市进一步优化产业发展路径提供了重要参考依据。我局会同市工信局认真研究相关建议，现答复如下：

一、目前工作进展

苏州是国内较早布局半导体与集成电路产业的城市，已形成以“设计、制造、封测”为核心，“设备、材料及服务”为支撑的完整产业链，是国内集成电路产业链较完整、企业集聚度较高的区域之一。近年来，针对提案中提出的“研发强、转化弱”、

“材料-工艺-器件”协同不足、核心技术与装备自主可控能力不足等问题，我市重点开展了以下工作：

一是强化顶层政策引领，夯实产业发展支撑。2025 年我市先后出台《苏州市 AI 芯片产业创新发展三年行动计划(2025 ~ 2027 年)》《苏州市加快发展 AI 芯片产业的若干措施》等专项政策，明确聚焦 GPU 通用芯片、ASIC 专用芯片、FPGA 半定制芯片、存算一体芯片、硅光芯片、网络互联芯片六大发展方向，持续加大集成电路芯片流片等关键环节补贴力度，精准赋能 AI 芯片产业提速发展。2026 年 1 月，我市在“十五五”发展规划建议中，将半导体与集成电路确立为重点培育新兴支柱产业，依托本地产业集群坚实根基，持续巩固“设计—制造—封测—材料设备”全链条发展优势，聚力攻坚先进制程、高端半导体材料等核心瓶颈，加快打造具备全球核心竞争力的优势产业。

二是着力打造高能级创新平台，筑牢产业创新根基。全力推动苏州实验室“去筹转建”，其牵头布局的材料综合研究设施成功纳入国家“两重”项目，顺利争取超长期特别国债资金扶持。持续建设国家第三代半导体技术创新中心（苏州）平台，支持其牵头组建第三代半导体装备国产化创新联合体，集中攻关推出光刻、刻蚀、薄膜沉积等一批核心工艺装备成果，稳步推进国产半导体设备工艺迭代验证与市场化规模化替代。加快推进苏州市 RISC-V 开源芯片产业创新中心建设，目前已成功研制十余款标杆芯片产品，累计与 20 家市场主体达成 IP 核授权应用合作，联

动 4 所高校搭建产学研协同研发体系；依托平台优势推动江苏省 RISC-V 产业联盟正式落地苏州，集聚产业链上下游优质资源，加速构建特色鲜明、协同联动的产业集群。

三是加快服务平台支撑赋能，强化全链条服务保障。一方面，提升现有公共服务平台效能，2025 年，中科集成 EDA 平台聚焦中小企业设计需求，累计服务半导体与集成电路企业 70 家，助力企业降低设计成本、提升研发效率；电子五所华东分所集成电路质量保障服务平台为 45 家企业提供可靠性测试、质量认证等服务，筑牢产业质量防线；纳米所加工平台精准对接研发需求，服务本地研发项目 20 余个，支撑前沿技术原型开发。另一方面，加快重点平台建设，推进铌酸锂中试平台建设，聚焦薄膜铌酸锂高速调制芯片等前沿领域，提供关键工艺验证、小批量试产等服务；聚焦半导体显示材料基础科学研究，加快建设中国科学院半导体显示材料与芯片重点实验室，突破核心技术瓶颈，为产业高质量发展提供基础支撑。

四是健全成果转化保障机制，深化产学研用深度融合。持续开展校企成果对接，2025 年建设“苏创荟”线上平台，同步设立成果超市，整合半导体领域高校和科研机构科技成果 2000 余项，加速科创项目落地与科技成果转移转化。持续建设苏州市研发资源共享服务平台，重点面向半导体材料、先进工艺等领域汇聚上海交通大学、同济大学、江苏集萃新材料研发有限公司等高

校、科研院所及第三方专业机构 484 家，整合三维原子探针、双束电镜与飞秒激光联用系统等高端仪器设备，为区域产业创新提供强有力硬件支撑。

五是着力突破关键核心技术，提升产业链自主可控水平。一方面，加大对上争取，积极推荐优质项目申报国家、省级重大科技计划，2025 年，“面向量子精密测量的百 Hz 级超窄线宽高功率半导体激光芯片及器件关键技术研发”等 8 个项目获省前沿技术和省科技重大专项立项支持，获得省拨经费 7500 万元。另一方面，支持本地企业自主创新，聚焦半导体新材料、先进工艺设备等重点细分领域精准布局技术攻关项目，2025 年支持“基于 RISC-V 架构的高性能抗量子密码芯片关键技术研发”等 27 个市级技术攻关项目，支持市级财政经费 1.29 亿元，强化自主创新能力，推动半导体产业链自主可控。

二、下一步重点工作

下一步，我们将根据提案中的意见建议，聚焦产业链重要材料、重大装备等关键环节，在技术联合攻关、平台建设、成果转化等方面创新工作举措，进一步推动我市前沿半导体产业发展。

（一）实现平台赋能跃升。一是强化高能级平台引领带动。服务保障苏州实验室建设，高水平建设材料综合研究设施，支持苏州实验室与本地龙头企业共建联合研发中心，聚焦前沿材料、核心工艺等领域开展重大科研攻关，推动科研资源与产业需求深

度融合。推动第三代半导体国家技术创新中心等重大平台构建创新网络，加快向企业导入人才、技术、成果等资源。二是强化产业创新平台支撑，加快砷酸锂中试平台、RISC-V 开源芯片产业创新中心等重点平台建设，壮大产业集聚规模、构建自主可控的产业生态；引导各类半导体专业服务平台扩容提质，完善技术研发、工艺验证、检测认证、人才培养等全链条服务功能，全面提升服务精准度和效能，持续激活产业创新内生动能。

（二）推动技术联合创新。一是深化院企精准对接。常态化开展“企有所需·研有所应”系列对接活动，持续征集梳理半导体企业技术痛点、攻关需求，建立规范化技术需求储备项目库，精准匹配高校院所、科研机构创新资源，加快形成一批具有市场竞争力的标志性半导体产品。二是聚焦重点领域攻关。围绕 RISC-V 开源芯片、GPU 通用芯片、硅光异质集成、第三代半导体材料等重点领域，持续推动企业与高校院所深度合作，集中力量开展关键核心技术攻关，加快突破一批制约产业发展的卡点、堵点技术，提升产业链核心竞争力。三是强化协同攻关机制。推动半导体龙头企业牵头组建实体化创新联合体，联合产业链上下游企业、科研机构、高校协同发力，开展产学研用一体化联合攻关，带动产业链整体创新能力提升。

（三）加速科技成果转化应用。充分发挥全国高校区域技术转移中心、先进技术成果长三角转化中心等高能级成果转化平台作用，整合区域内高校、科研院所、企业等创新资源，搭建精准

高效的成果转化桥梁，切实推动更多高质量半导体科技成果从实验室走向生产线、转化为现实生产力。加快培育一支专业化、复合型技术经理人队伍，加强业务培训和能力提升，规范技术转移服务流程，提升技术转移服务专业化、市场化水平。健全科技成果转化激励机制，优化技术交易环境，有效促进半导体领域技术合同成交额稳步增长，激发技术市场活力，推动创新成果加速落地、形成产业实效。



（此件依申请公开）

联系人姓名：韩文佳

联系电话：65227947

抄送：市政府办公室、市政协提案委、市工信局